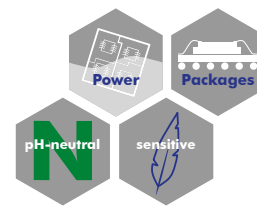


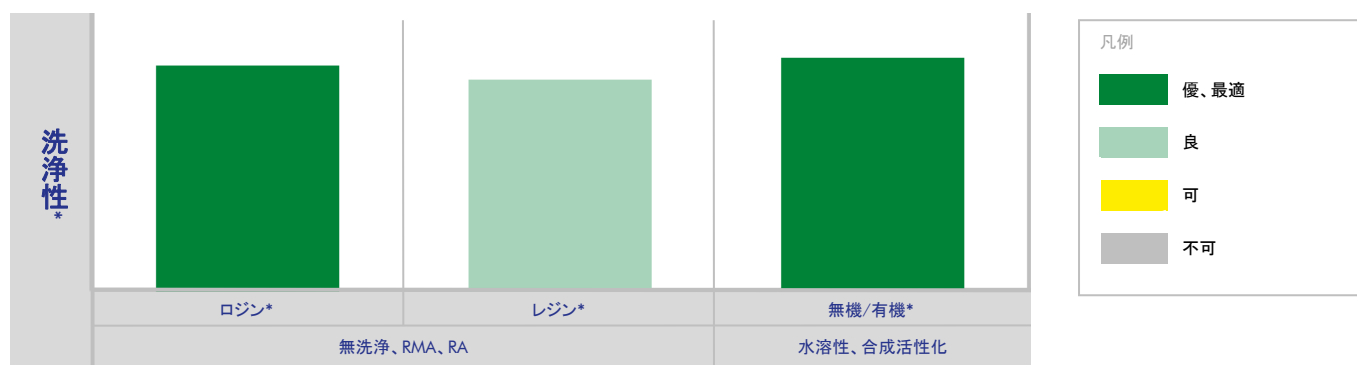
HYDRON® SE 220

半導体向け 中性フラックス洗浄剤



HYDRON® SE 220 は浸漬工程用一相タイプ水系洗浄剤です。リードフレーム、ディスクリート部品、パワーモジュール、パワーLED、フリップチップや CMOS といった各種の半導体パッケージからダイアタッチ時などに発生するフラックス残渣を除去します。一相構造のため、非常に優れた工程管理性と良好なリンス性を示し、ワイヤボンディングやモールディングなどの後工程を最適な表面状態に仕上げることができます。中性のため、材料適合性にも優れています。

アプリケーション - 半導体エレクトロニクス洗浄



* J-STD-004

他洗浄剤と比較した利点

- 一相構造のため工程管理が容易で、浸漬工程において優れた性能を発揮します。
- イオン交換水でのリンス性が良好で残渣を残しません。
- 中性のため、特にダイとの材料適合性に優れていて、チップパッシベーションへのアタックもありません。
- 銅表面をシミなく活性化し、ワイヤボンディング・モールディング・接着ボンディングなどの後工程に適応します。また活性化された表面を一定期間保持させることができます。
- 引火点がなく、低臭気のため、防爆仕様なしで浸漬洗浄槽に導入できます。

工程

洗浄工程	部品	1. 洗浄	2. リンス	3. 乾燥
超音波/噴流	パワーモジュール、 リードフレーム、 ディスクリートデバイス、 パワーLED、 フリップチップ、CMOS	HYDRON® SE 220	イオン交換水 ¹	温風、空気循環

¹イオン交換水の液温は 20-40°Cとします。